

Memorial Descritivo

SPI KY8030-2L

1. Descrição:

MÁQUINA AUTOMÁTICA DE INSPEÇÃO DE PASTA DE SOLDA 3D, POR MEIO DE CAMERÂ DE VIDEO DIGITAL, COMPUTADORIZADA, COM SISTEMA DE FUNÇÕES XY COM SERVOMOTORES, COM RESOLUCAO DE 20 MICRONS, PARA TENSÃO DE 200 A 240VAC, COM FREQUÊNCIA DE 50 60HZ (FASE SIMPLES), COM DIMENSÕES DE 1203X1000X1512MM, MODELO KY8030-2L, FABRICANTE KOHYOUNG,

2. Especificações:

Faixa de Inspeção	
Capacidade de Metrologia	Volume, Área, Altura, Offset e deformidade da forma
Tipos de Defeitos	Pasta insuficiente / excessiva / ausente, ponte, deformidade da forma e colar offset
Princípio de Medição	Sombra 3D Livre "Moiré"
Tecnologia da Camera	
Camera	2MPix
Resolução do Pixel XY	20 µm / 0.79 mils
Resolução Z	0.37 µm / 0.015 mils
Performance da Inspeção	
Velocidade de Inspeção a 20 µm Modo Sombra Livre	15.0 cm ² /sec
Modo de alta velocidade	19.7 cm ² /sec
Repetição de volume (em um alvo de calibração KY)	< 1% at 3 σ
Repetibilidade de volume (em um PCB)	< 3% at 3 σ
Precisão de Altura (em um Alvo de Calibração KY)	2 µm
Gage R & R (tolerância ± 50)	<< 10 % at 6 σ
Max. Compensação de Warp PCB	± 3.5 mm
Max. Altura da Pasta	400 µm /15.75 mils

Min. Tamanho do depósito de pasta de 20 µm, Retângulo	150 µm / 5.91 mils
Min. Tamanho do depósito de pasta de 20 µm, Círculo	200 µm / 7.87 mils
Min. Distância entre Depósito de Pasta	100 µm (a 150 µm de altura de pasta) 3,94 mils (a 5,91 mils de pasta de altura)
Configuração de PCB	
Ajuste da largura do transportador	Automático
Tipo de correção do transportador	Frente / Traseira Fixa (Configuração de Fábrica)
Altura do transportador	970 ~ 870 mm
Max. Tamanho do PCB	510 x 510 mm
Min. Tamanho do PCB	50 x 50 mm
Espessura do PCB	0,4 ~ 5,0 mm
Max. Peso do PCB	2,0 kg
Requisitos de sistema e instalação	
Fornecimento Elétrico	200 ~ 240VAC, 50/60 Hz fase simples
fornecimento Pneumático	5 Kgf/cm ²
Sistema Operacional	Windows XP Professional
S/W	
Ferramenta de análise estatística	SPC Plus
Geração do Programa de Inspeção	Importar dados GERBER (274X, 274D)
Opções	Cabeça de zoom (Autozoom de 15, 20, 30 µm)
	• Estação de Revisão de SPC e Defeitos Off-line
	• Estação de Programação Off-line • Conversão de Arquivos ODB ++
	• Leitor de código de barras (1D / 2D) • Raid 1 do HDD (espelhado)
	• Alvo de calibração certificado • UPS
Dimensões da Máquina (CxLxA) mm	1203 x 1000 x 1512
Peso da Máquina	550 kg

3. Principais Características:

Programação Rápida

Menos de 10 min de programação para um arquivo completo de inspeção, sem necessidade de ajuste fino.



Solução de conformidade precisa

A única maneira de garantir a junção do volume de solda correta dentro dos requisitos IPC 610.



Melhor Performance de Medição em SPI

- $<< 10\%$ de GR & R a 6σ
- Repetibilidade do volume $<1\%$ a 3σ em um alvo de calibração KY
- Repetibilidade média do volume $<3\%$ a 3σ num PCB



Detecta todos os defeitos incluindo depósitos insuficientes e excessivos de pasta, deformação da forma, colagem offset, manchas, ponte e mais.

4. Fotos dos Equipamentos:



Figura 1 - SPI KY8030-2 (vista externa)



Figura 2 - SPI KY8030-2 (vista interna)

5. Anexos:



KY 8030 Series.pdf